



6-3-2024

Práctica 2

Arquitectura de computadoras

Alumno: Christopher Alejandro Medina Vargas

Matricula: 22050781

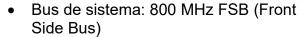
Equipo 2



Imagen Descripción Nombre: Intel Celeron N3050 Familia: Intel Celeron Arquitectura: 64-bit Núcleos: 2 Hilos: 2 Frecuencia base del procesador: 1.6 GHz Frecuencia máxima del procesador: 2.16 GHz Caché: 2 MB Litografía: 14 nm TDP (Potencia de diseño térmico): 6 W Gráficos integrados: Intel HD Graphics (Gen 8) Frecuencia base de gráficos: 320 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 600 MHz Soporte para memoria RAM: DDR3L/LPDDR3 hasta 8 GB Tecnología de virtualización Intel (VT-x): Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d): No Conjunto de instrucciones: 64-bit Tecnología de ejecución confiable Intel: Tecnología de protección de identidad Intel: Sí Tecnología de protección de plataforma Intel: No Tecnología Intel Turbo Boost: No Nombre: Intel Pentium Dual-Core E2140 Familia: Intel Pentium Dual-Core Generación: Serie E2xxx Tipo de zócalo: LGA775 Arquitectura: 64-bit Núcleos: 2 Hilos: 2 Frecuencia base del procesador: 1.60

GHz

Caché L2: 1 MB (compartido)



• Litografía: 65 nm

• TDP (Potencia de diseño térmico): 65 W

 Soporte para memoria RAM: DDR2-667 / DDR2-800

Tecnología de virtualización Intel (VT-x):
 No

 Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d): No

• Conjunto de instrucciones: 64-bit

 Extensiones de conjunto de instrucciones: MMX, SSE, SSE2, SSE3

 Tecnología de ejecución confiable Intel: No

 Tecnología de protección de identidad Intel: No

 Tecnología de protección de plataforma Intel: No

 Tecnología Enhanced Intel SpeedStep (EIST): Sí



Modelo: SL6RM

Familia: Intel Xeon

Generación: Prestonia

Socket: Socket 604 (mPGA604)

Arquitectura: 32-bit

Núcleos: 1

Hilos: 2 (Hyper-Threading Technology)

Frecuencia base del procesador: 3.06
 GHz

Caché L2: 512 KB

Bus frontal (FSB): 533 MHz

• Litografía: 130 nm

TDP (Potencia de diseño térmico): 69 W

Tecnología de virtualización Intel (VT-x):
 No

 Extensiones de conjunto de instrucciones: MMX, SSE, SSE2, SSE3

• Soporte para memoria RAM: DDR266

Chipset compatible: Intel E7501 (Plumas)







- Arquitectura: x86
- Socket: Los primeros Pentium 4 utilizaron el socket 423, luego pasaron al socket 478 y finalmente al LGA 775.
- Frecuencia de reloj: Los primeros modelos tenían frecuencias desde 1.3 GHz hasta 2.0 GHz, pero con el tiempo, las frecuencias aumentaron significativamente, llegando incluso a superar los 3.8 GHz en algunos modelos extremos.
- Caché L2: Inicialmente, la mayoría de los Pentium 4 tenían 256 KB de caché L2, pero en modelos posteriores esto se aumentó a 512 KB y 1 MB.
- Tecnología Hyper-Threading (HT):
 Algunos modelos del Pentium 4 incluían la tecnología Hyper-Threading, lo que permitía a cada núcleo ejecutar dos subprocesos simultáneamente.
- Bus frontal (FSB): Inicialmente a 400 MHz, posteriormente a 533 MHz, 800 MHz y finalmente a 1066 MHz.
- Litografía: Varía según el modelo específico, pero los primeros modelos se fabricaron en un proceso de 180 nm, mientras que los modelos posteriores en 90 nm y 65 nm.
- TDP (Potencia de diseño térmico):
 Dependía de la generación y del proceso de fabricación, pero podía variar entre 55 W y 115 W.
- Soporte para memoria RAM: DDR y DDR2 dependiendo del chipset y la placa base utilizada.